



RELATÓRIO DE NPI

FR455

REFERÊNCIAS BÁSICAS

CÒD. PRODUTO ACABADO: 342753275

DESCRIÇÃO: 73

Nº OP: 737

CLIENTE: SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI

QTDE TOTAL OP: 7378

QTDE NPI: 732

DATA: 2023-01-17

APRESENTAÇÃO DO NPI

Aplicação do Produto: 37

Classe (IPC-A-610): 73853

Documentação está Ok : SIM

Falta o documento de:

Item possui revisão anterior: SIM

Qual cód.?

Origem do Stencil?

Data de chegada: 2023-01-17

Etiquetas do cliente? SIM

Quant. Etiquetas:

Tipo de Liga: Lead free

Instr. de Montagem Especial? SIM

Os componentes possuem especificações quanto à altura, clinche ou ângulo?

☐

Todos os cabos contêm suas especificações?

☐

Existem especificações e desenhos de montagem do produto?

☐

Existem especificações e desenhos de montagem do produto?

☐

☐ Embalagem é pertencente ao Cliente?

Etapas produtivas:

☒ SMT Bottom

☐ Mont. PTH

☐ Teste

☐ OBA

☐ SMT Top

☐ Mont. Lean

☒ ICT

☐ Certificado de Qualidade

☐ AOI

☐ Verniz

☐ Gravação

☐ Registro de Histórico do Produto

☐ Outros

☐ Produtos Químicos (NOVO)

Ações de melhoria:

☒ desenvolver gabarito

☐ recolher documentação

☒ painelizar PCI

☐ Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional...)

Comentários quanto a apresentação do novo produto:

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO

Participantes:

Eng. de Processo PTH: Anna Paulla da Rocha

Eng. de Teste: Fernando Borges

Eng. de Processo SMT: Diogo Pereira

Comercial: Leticia Fernanda

Eng. da Qualidade: ADRIANA FERREIRA

Outros: ADRIANA FERREIRA

REALIZAÇÃO DO NPI

ALMOXARIFADO

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2023-01-17

Atividade: Separação de materiais no almoxarifado

☒ Foi identificadodd alguma divergência de materiais?

☒ Algum componente será montado sob desvio?

Comentários quanto a apresentação do novo produto:
tesst01

MONTAGEM SMT

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DA MONTAGEM SMT

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2023-01-17

Atividade: Printer

Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

☒

Tipo de insumo aplicado? ADESIVO

Tipo de apoio utilizado na Printer?

Inspeção por SPI?

☐

Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐

Atividade: Inserção automática

Em qual linha foi realizado o NPI?

Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐

Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐

Atividade: Reflow e Inspeção

Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"?
☐

Se NÃO, informar nome do perfil utilizado:

Realizado inspeção visual?
☒

Utilizado Raio-X? *
☐

Atividade: Router

Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI?

Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?
☒

VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM SMT (RUN10)

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2023-01-17

VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM SMT

Seq. de Placas (número de série)

OK/FALHA

Descrição da Falha

Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT: xdawd

Houve problemas críticos? xdwa

Gerado documento devido a problemas? xawxd

Verificação da Montagem SMT APROVADO

Validado por: Wagner Espricigo Maia

Junto com: Wagner Espricigo Maia

MONTAGEM THT/LEAN

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DA MONTAGEM THT/LEAN

Responsável: Wajdi Ben Helal

Data: 2023-01-17

Atividade: Pré forma

Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação?
☒

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?
☒

Atividade: Cablagem

As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?
☐

Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?
☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?
☐

Atividade: Pré compor

Houve alguma dificuldade na depainelização?

☐

Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Compor

Foi identificado algum problema durante a montagem?

☐

Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Soldar PTH/Inspeção

Foi identificado algum problema durante a operação de montagem?

☐

A atividade de Touch up será necessário?

☐

O layout da placa facilita a operação de ressolda?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Montagem Mecânica/Montagem Final

Todos os componentes contêm suas especificações?

☐

As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?

☐

Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?

☐

Existe a aplicação de verniz no produto?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM THT/Lean (RUN10)

Responsável: Wajdi Ben Helal

Data:

VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM THT/LEAN

Seq. de Placas (número de série)

OK/FALHA

Descrição da Falha

Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem THT/Lean: xdaw

Houve problemas críticos? 1

Gerado documento devido a problemas? ☒

Doc.:

APROVADO

Validado por: Wagner Espricigo Maia

Junto com: Wagner Espricigo Maia

TESTES

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DO TESTE

Responsável: Wajdi Ben Helal

Data:

EXECUÇÃO DO TESTE

Qual tipo de teste é realizado?

Testes/Jiga desenvolvido por?

☒ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?

☒ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

☒ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum “choque mecânico”?

☒ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

RESULTADOS DO TESTE

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2023-01-17

VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE

Seq. de Placas (número de série)	OK/FALHA	Descrição da Falha
Comentários técnicos e Análise crítica referente ao Testes: xdaw		

EMBALAGEM

Run10 nº.:

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2023-01-17

Atividade: Embalagem

☐ Há necessidade de etiqueta ESD?

☐ Comentários técnicos referente a etapa de Embalagem:

Qual tipo de embalagem será utilizado?
SACO ANTIESTÁTICO

Como a embalagem será fechada? FITA ANTIESTÁTICO

REUNIÃO DE FECHAMENTO (report de mudanças e validação final)

Organizador (Eng. da Qualidade) : Ana Paula Jahnz

Data: 2023-01-17

Participantes:

Eng. de Processo PTH: Anouar

Eng. de Teste: Ageu Reis de Paiva

Eng. de Processo SMT: João Ramiro

PCPM: Ageu Reis de Paiva

ANÁLISE CRÍTICA: xdwa

Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças)

Wajdi Ben Helal



Data hora enviar : 2023-01-17 10:27:59

Data hora aprovada : 2023-01-17 10:28:22

PARECER FINAL STATUS

APROVADO

Com restrições? SIM

Implementação de: xdaw

Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) (autorização de mudanças)

Wajdi Ben Helal



Data hora enviar : 2023-01-17 10:28:14

Data hora aprovada : 2023-01-17 10:28:25

Novo Run10 é possível? *outra tentativa imediata para nova análise crítica SIM